

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年1月16日(16.01.2014)



(10) 国際公開番号

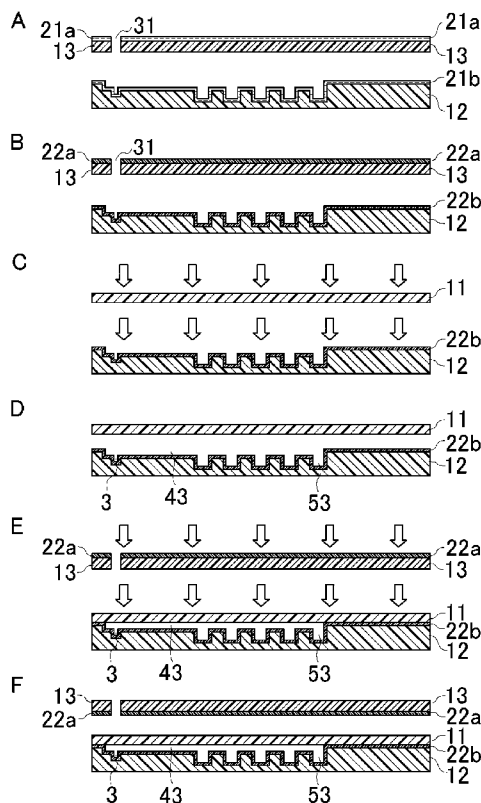
WO 2014/010299 A1

- (51) 国際特許分類:
G01N 35/08 (2006.01) G01N 37/00 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/063054
- (22) 国際出願日: 2013年5月9日(09.05.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-153584 2012年7月9日(09.07.2012) JP
- (71) 出願人: ソニー株式会社 (SONY CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 渡辺 英俊 (WATANABE Hidetoshi); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 瀬川 雄司 (SEGAWA Yuji); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 加藤 義明 (KATO Yoshiaki); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 渡邊 薫 (WATANABE Kaoru); 〒1080074 東京都港区高輪2丁目20番29号サクセス泉岳寺ビル3階薫風国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: MICROCHIP AND METHOD FOR PRODUCING MICROCHIP

(54) 発明の名称: マイクロチップ及びマイクロチップの製造方法



(57) Abstract: Provided is a technology for increasing the join strength between each substrate layer of a plurality of substrate layers configuring a microchip. Provided is a microchip that comprises: a plurality of substrate layers; and join layers that are provided to the interfaces between the substrate layers and that comprise a silicon compound, at least one of the join layers comprising an organic silicon compound. In this microchip, even when a plurality of substrate layers of differing materials are combined, the join strength between each substrate layer of the plurality of substrate layers can be heightened.

(57) 要約: マイクロチップを構成する複数の基板層の、各々の基板層間の接合強度を高めるための技術の提供。複数の基板層と、前記基板層の界面に設けられた、ケイ素化合物からなる接合層とからなり、前記接合層のうち少なくとも1つは有機ケイ素化合物からなる、マイクロチップを提供する。このマイクロチップにおいては、材質の異なる複数の基板層が組み合わされた場合であっても、複数の基板層の各々の基板層間の接合強度が高められ得る。

WO 2014/010299 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))